



汎銓科技 半導體高階製程領航者
www.msscorps.com

汎銓科技股份有限公司

MSSCORPS CO., LTD.

壹

公司簡介

公司基本資料
經營團隊
營運據點
公司沿革
TEM 流程

貳

服務客群

第一、二、三類
半導體
HPC/5G/AI/IoT
/雲端資料

參

經營實績

營業收入 +30 %
稅後純益 +94 %
EPS +78 %
營業毛利 +42 %

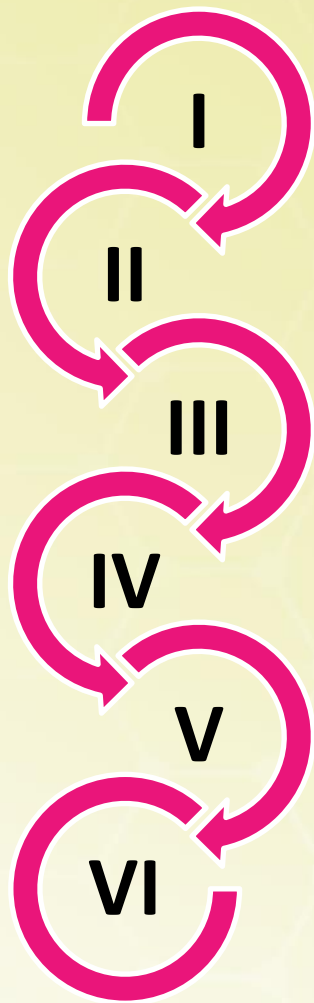
肆

技術優勢

超前部署先進分
析設備;自主開發
研發分析技術
EUV/Low-*k*/超薄
試片製備技術

壹 公司簡介

公司基本資料



汎銓科技股份有限公司
MSScorps CO.,LTD.
簡稱MSS

設立時間: 民國94年7月27日

創辦人: 柳紀綸董事長兼總經理

資本額: 新台幣4.12億元
/員工: 350人

服務項目: 材料分析(MA)、故障
分析(FA)、表面分析(SA)

專業認證: *ISO 9001, IECQ ISO
17025, ISO 27001*

MA **FA** **SA**

TEM 3D XRAY SIMS

FIB THz TDR XPS

SEM InGaAs Thermo OBIRCH AFM

EDS Nano probe FTIR

EELS FIB 電路修補

經營團隊

董事長兼
總經理暨執行長
柳紀綸

淡江大學應用物理系學士
聯華電子產品部工程師
聯華電子製造部副理
聯華電子生產企劃部副理
聯詠科技資材部經理



執行副總暨技術長
陳榮欽

清華大學材料科學工程博士
台積電產品部副理
晶研科技專案經理
閎康科技技術處長



資深副總 暨營運長
廖永順

清華大學材料科學工程碩士
台積電主任工程師
宜特科技部經理
采鈺科技副處長



副總經理 暨營運長
周學良

成功大學地球科學研究所碩士
合泰品質工程工程師
聯華電子故障分析課經理
和艦科技物性暨微量分析經理



副總經理 暨財務長
蘇靖棋

交通大學財務金融研究所碩士
勤業眾信會計師事務所審計員
群益金鼎證券企金部資深經理
康和證券承銷部業務協理



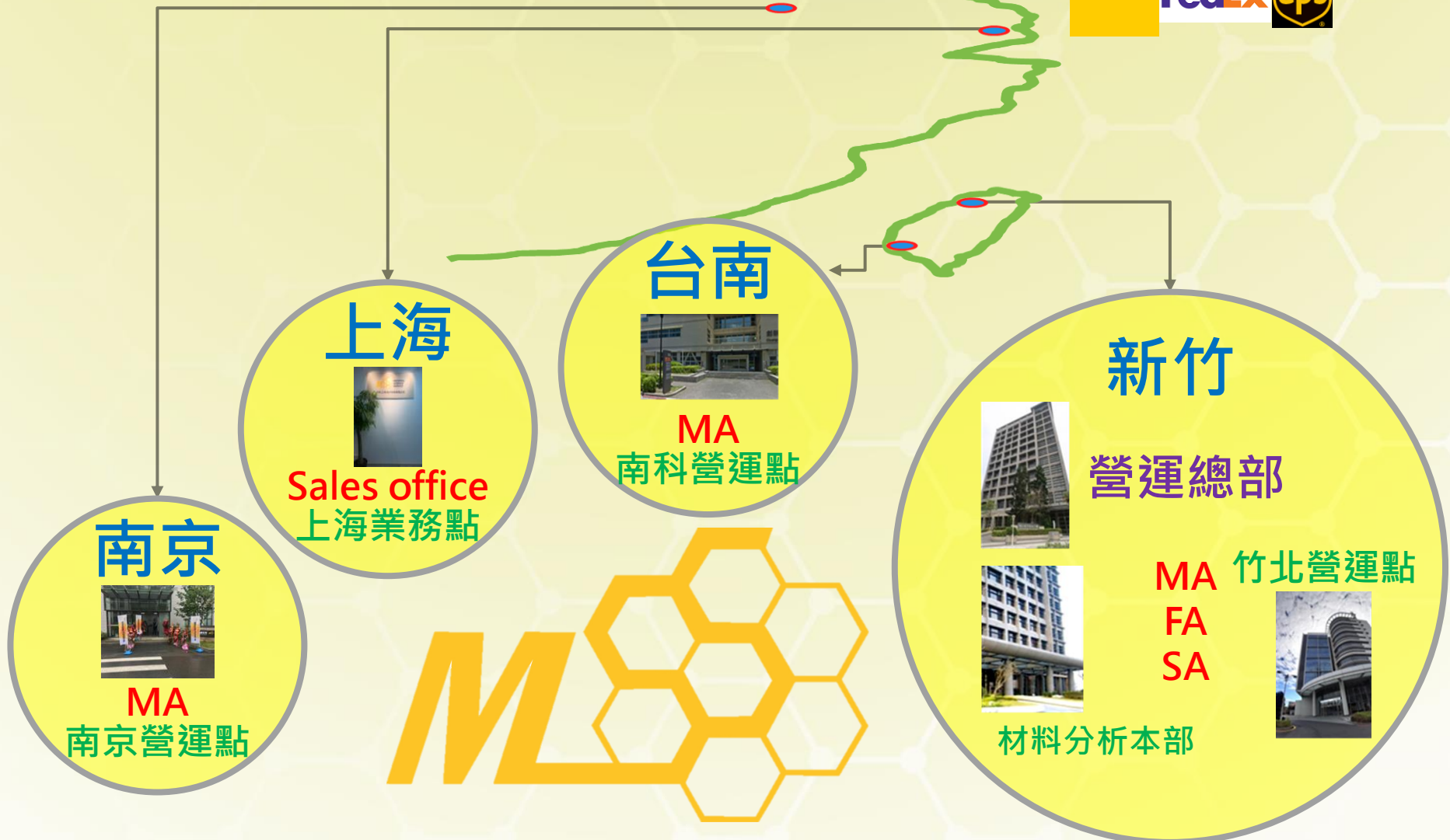
副總經理 暨資訊長
簡文祥

台灣大學資訊工程系學士
Oracle資深顧問
SAP資深顧問
SAS技術平台協理



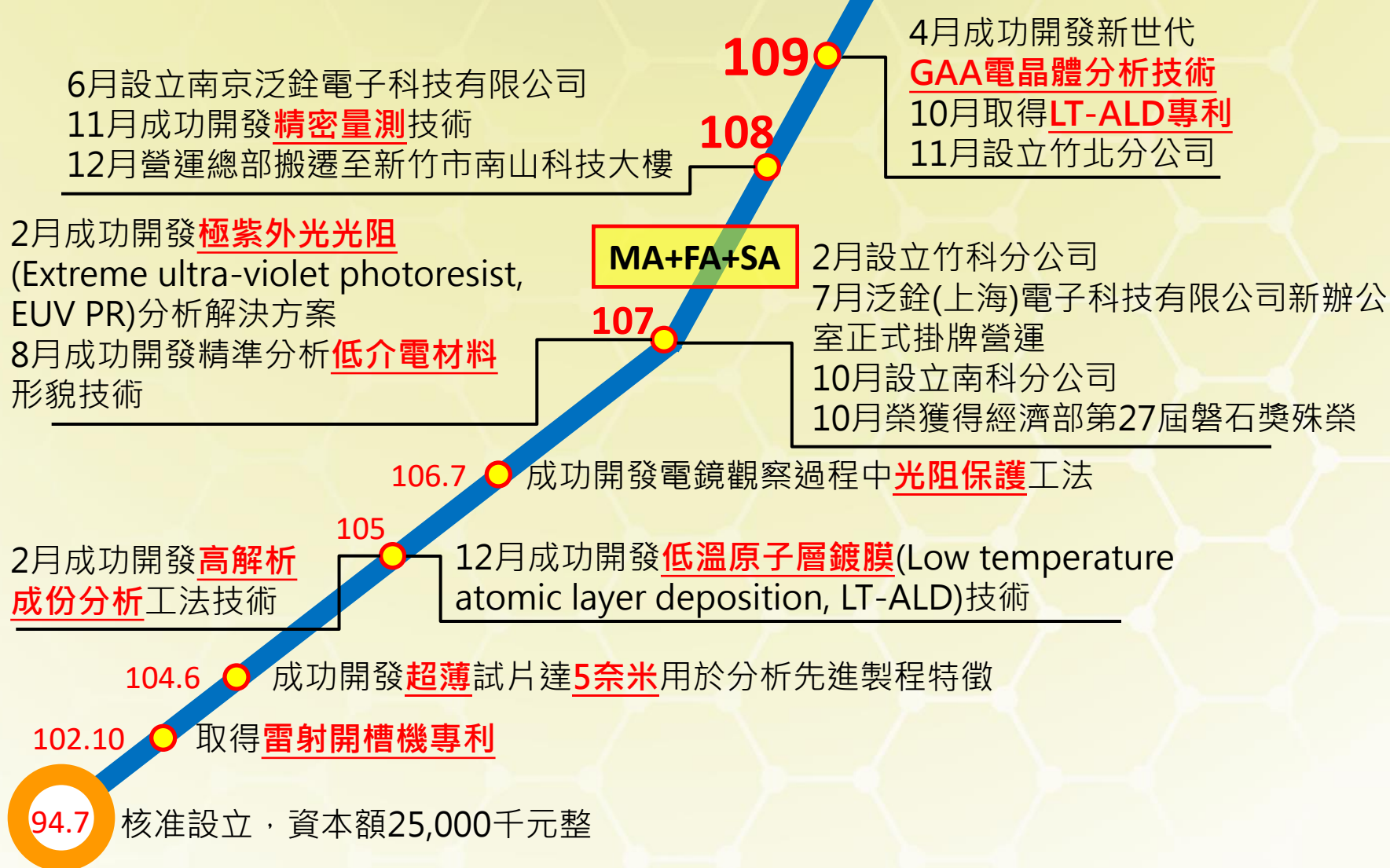
營運據點

美國/歐洲/日本/韓國/新加坡



立足台灣，服務全世界

公司沿革(大事記)



TEM分析流程

1

ALD材料



結構脆弱易變形，需要低溫ALD保護

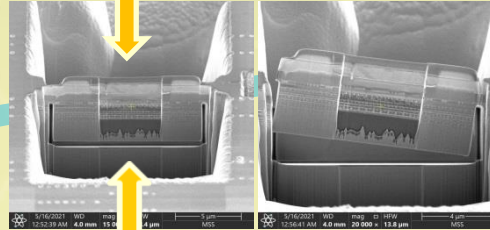
0



原始結構，奈米級尺寸，所以需要TEM

2

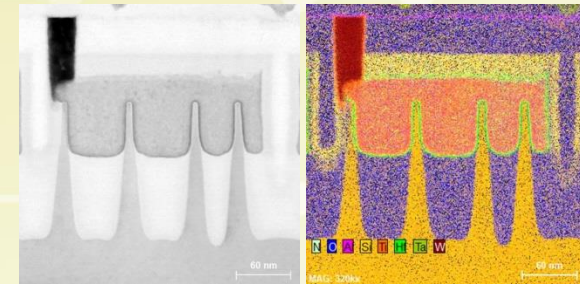
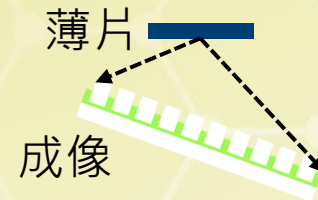
FIB製備
切削方向



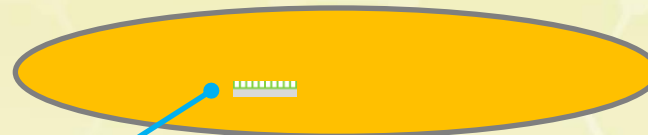
利用FIB將試片切成薄片(約5-100奈米)，取出試片

3

TEM
電子束



Reverse engineering from Samsung S8, 10 nm technology node



客戶委託樣品



1: ALD試片製備
2: FIB
3: TEM

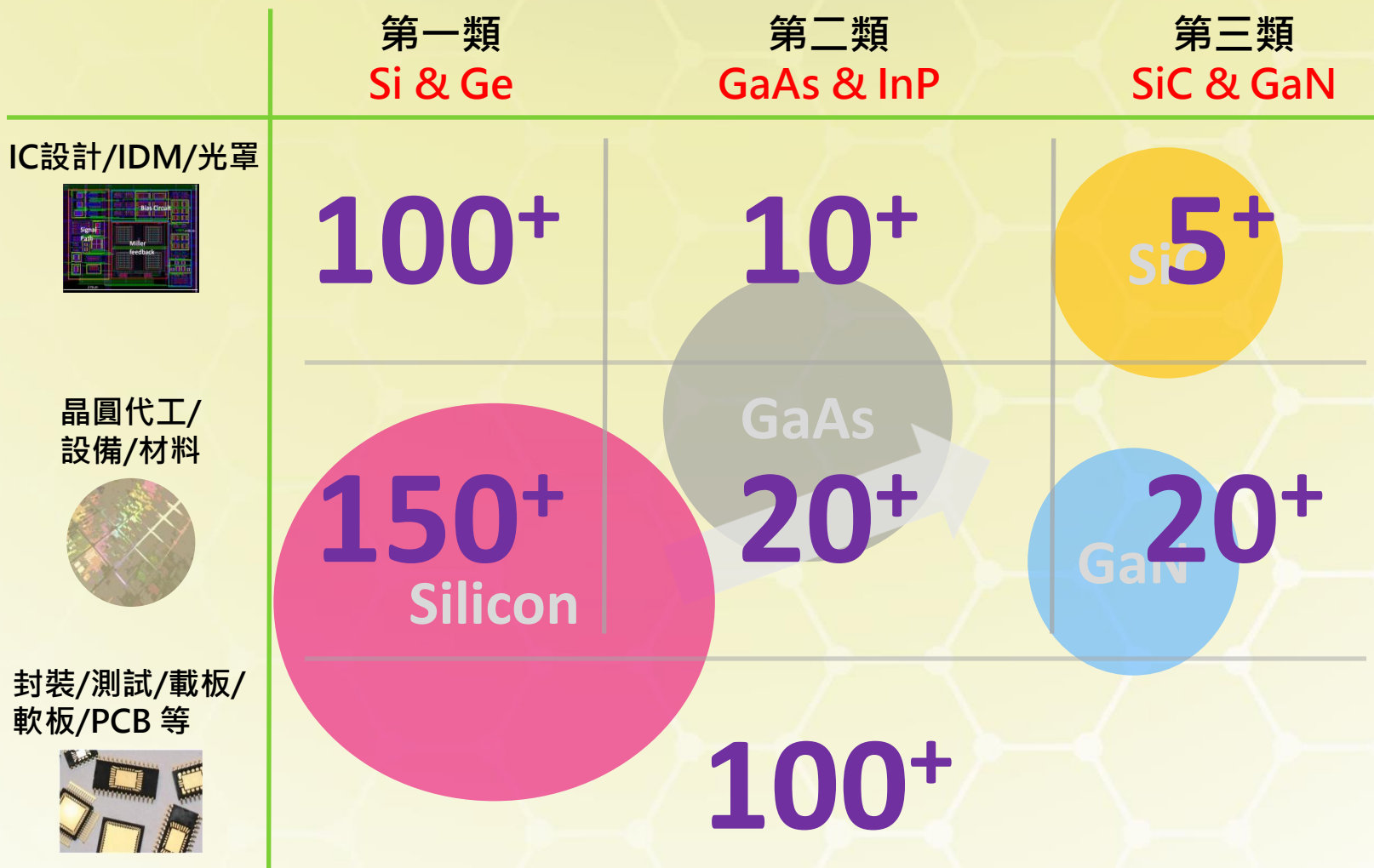
貳 服務客群

半導體產業高階製程研發必要的 Pilot 角色

研發領航	材料	應用	晶片
低損傷Low K/EUV保護		HPC/5G/AI/IOT/資料中心 智慧手機	CPU/GPU/FPGA AP/Modem/FEM
三維定位切片技術	Si & Ge	自駕車	ADAS/IVI
精準球高量測		記憶體	DRAM/V NAND
發光層摻雜顯像技術		CIS	Camera/Lidar
缺陷量化分析技術	GaAs	RF/光通訊	PA/Vcsel
異質接面研磨技術	GaN	快充	Power device
低對比材料顯像	SiC	逆變器	> 600 V Power device
TEM EDS+ SIMS 定量分析	OLED	micro- OLED	
低損傷電漿離子束(PFIB)分析技術	LED	mini /micro LED	
無刀痕離子束剖面研磨(CP)技術	Package	FO/FOPoP/InFO/CoWoS/WoW	
軟材料觀測技術	Substrate	BT/ABF	
	PCB	CCL/FCCL/HDI	

- 先進製程PPAC的優勢，新的材料與微縮結構，分析挑戰性持續增加
- 多樣性元件研發，汎銓超前布局分析技術，提供客戶正確資料
- 領航客戶研發成功time to market，獲得雙贏

汎銓廣大客戶群

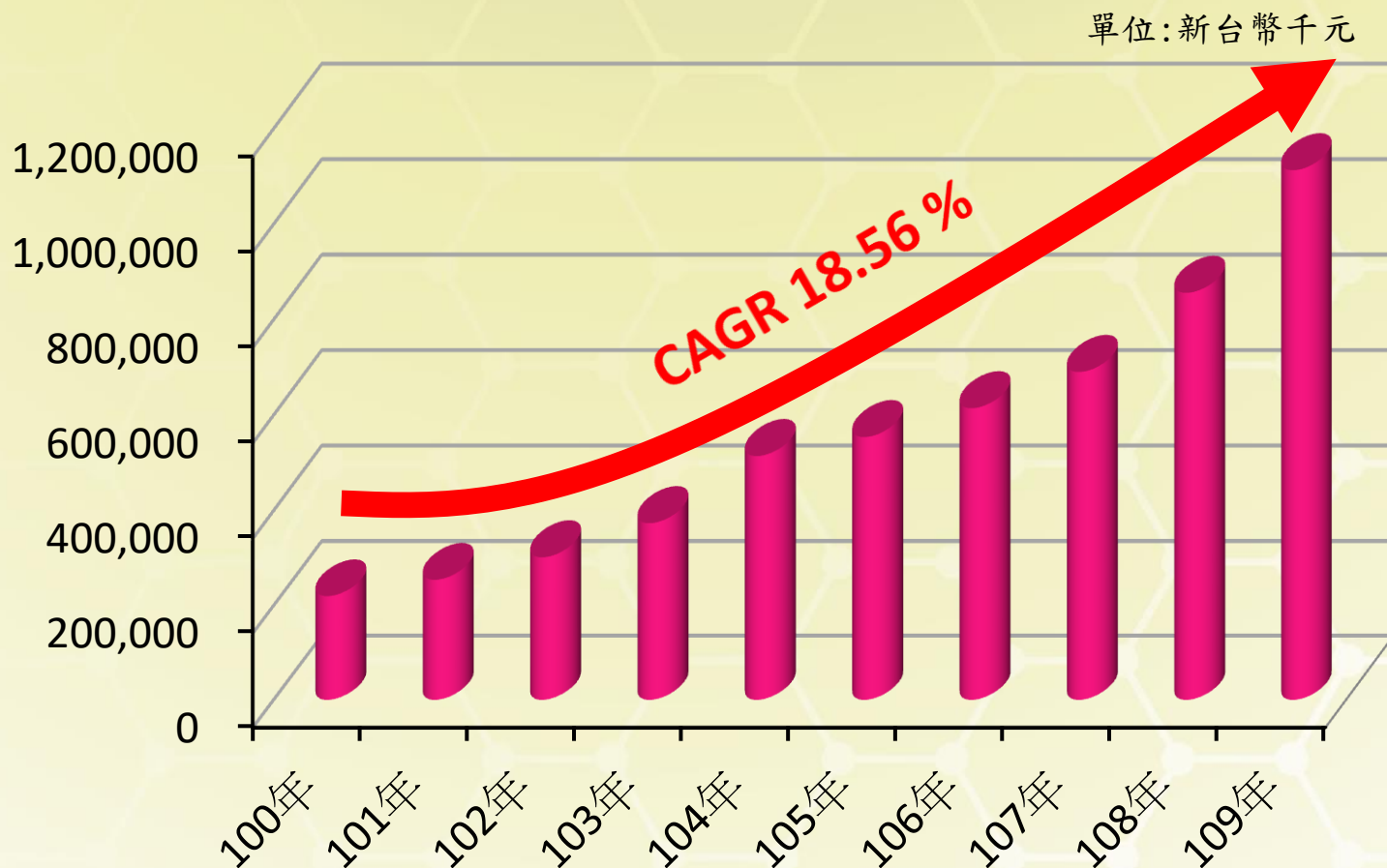


汎銓服務半導體公司數量



經營實績

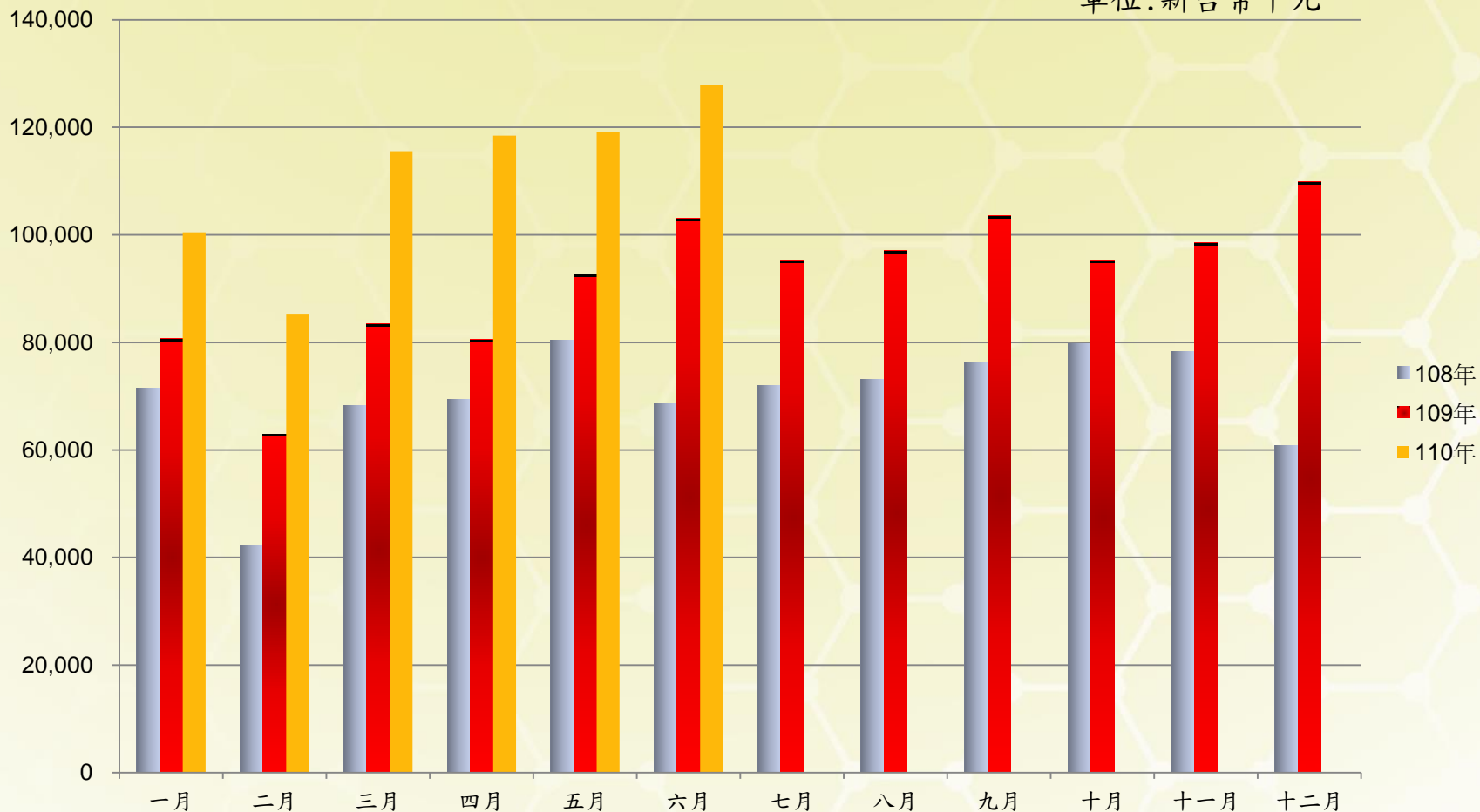
汎銓十年營收成長趨勢圖



★ 十年(100年~109年)複合年成長率 18.56%

汎銓108~110年度營收持續高度成長

單位:新台幣千元



經營實績

HPC/5G/AI/IoT/雲端資料/車用概念產業晶片需求大增，將進一步推升MA+FA+SA分析需求

	107	108	109	
營業收入(千元)	690,630	856,306	1,113,184	+30 %
營業毛利(千元)	257,449	288,437	410,323	+42 %
稅後純益(千元)	66,538	81,764	159,106	+94 %
EPS(元)	2.76	2.27	4.05	+78 %

肆 技術優勢

自主開發研發分析技術

More Moore

2015~2018

2019

2020

2021

2022~

超薄試片技術

光阻保護技術

鱗式電晶體精密成分分析

低損傷低介電層(Low K)保護

EUV 光阻解決方案

低對比材料分析

原子層沉積保護

軟材料觀測技術

缺陷量化分析技術

新世代電晶體 GAA環繞閘極電晶體分析

奈米製程微結構自動量測級距技術

感光元件球高精準量測

3D NAND 快閃記憶體分析

奈米級高解析成分分析

精密逐層去層技術

低損傷雙束電漿離子束(PFIB)分析技術

第二代EUV超小線寬光阻保護技術

A世代超薄試片製備技術

奈米級晶相分析

橫向環繞電晶體分析技術

原子級成分分析技術

More than Moore/High value system

2021

2022~

5G天線整合分析解決方案

散出型封裝解決方案

三維X光缺陷定位技術

銅混合鍵合分析

3D辨識之垂直面型雷射分析(VCSSEL)

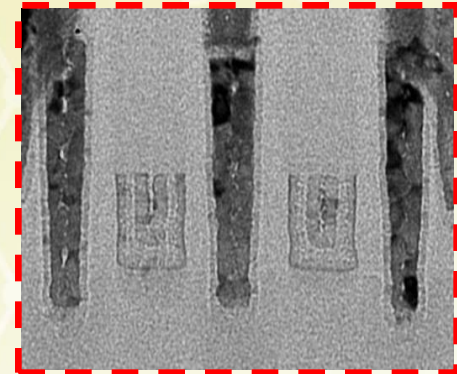
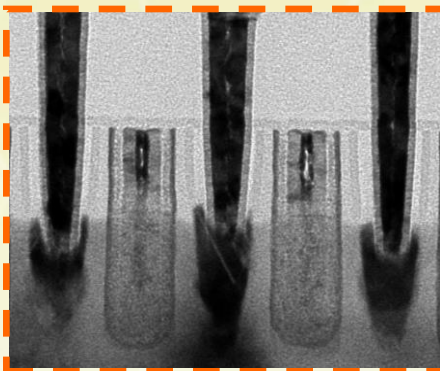
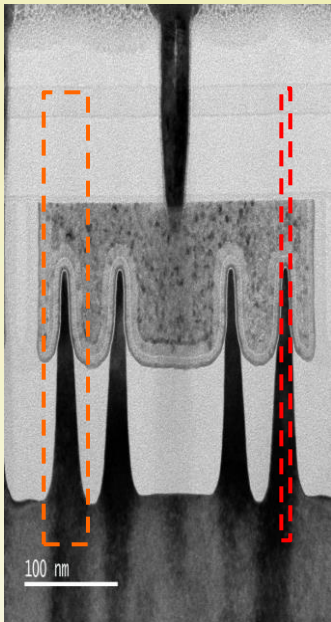
奈米級擴散分析

應力分析

微參雜分析技術

蝕刻顯像技術/異質界面研磨技術

Thickness control

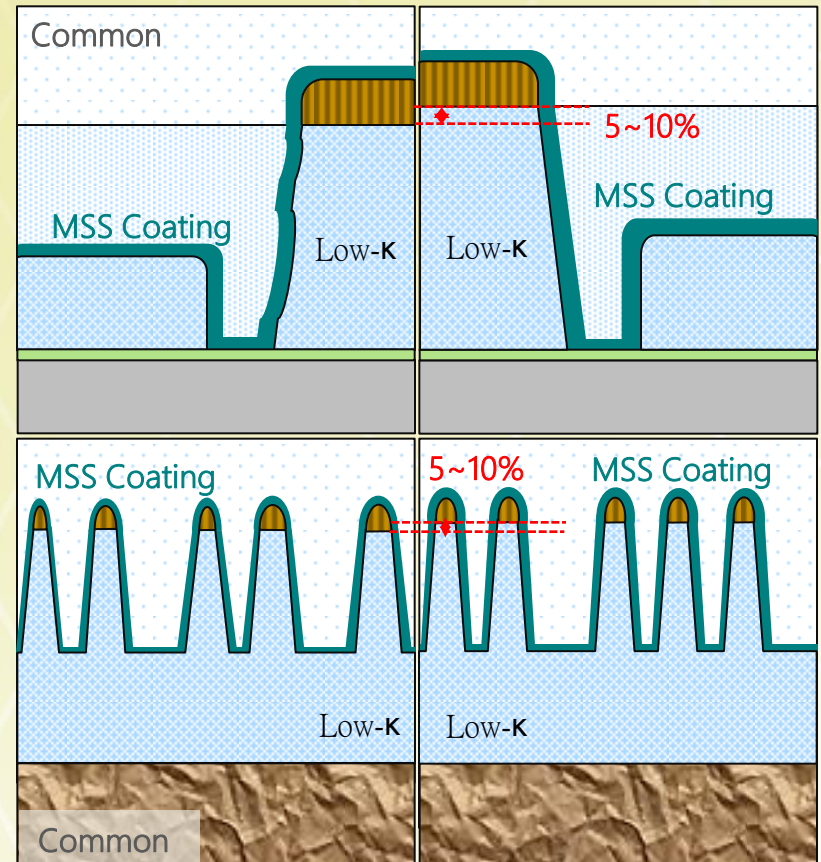
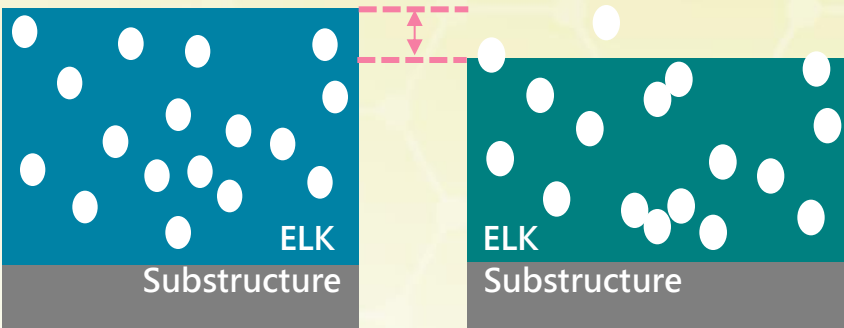


1. Prepare the sample of specific location through request.
2. MSS can prepare the ultra thin sample.

Ultra-thin sample ~ 5nm

Protection for sensitive material

Deformation during analysis process





Your best R&D partner



1F,NO.27,Pu-ding Rd., Hsin-chu
30072,Taiwan,R.O.C



+886-3-6663298



service@msscorps.com